

### Lagenaufbau

Ebene	Komponente	Dicke (mm)	Cu (my)	Typ
1	Cu+galv.Cu		70+25	
	Prepreg	0.183		7628
	Prepreg	0.183		7628
2	Cu	0.36	105	
	Tr-Lam		105	
3	Cu			
	Prepreg	0.183		7628
	Prepreg	0.183		7628
4	Prepreg	0.183		7628
	Cu	0.36	105	
	Tr-Lam		105	
5	Cu			
	Prepreg	0.183		7628
	Prepreg	0.183		7628
6	Cu+galv.Cu		70+25	

Presslingsdicke*	2,35	+/- 10%
Gesamtdicke inkl. galv. Cu u. Lötstopmmaske*	2,46	+/- 10%

### Bemerkungen zum Lagenaufbau:

- \* Dickenberechnung mit Basismaterial FR-4 gefüllt bei 50% Kupferbelegung auf Innenlagen (abhängig von Basismaterialtyp, gewählter Kupferdicke und Kupferbelegung abweichende resultierende Isolations- und Enddicken)
- Dickentoleranz Basismaterial +/-10%
- minimale Kupferenddicken gemäß IPC 6012 aktuelle Ausgabe

## Designrules zum Lagenaufbau

Durchgangslöcher [A] (Vias)	End-Ø	≥ 350 µm
	Viapad-Ø	≥ 800 µm
Leiterbild Außenlagen	Leiterbreite bei 50 µm Grundkupfer	≥ 160 µm
	Leiterabstand bei 50 µm Grundkupfer	≥ 215 µm
Standard	Leiterbreite bei 70 µm Grundkupfer	≥ 200 µm
	Leiterabstand bei 70 µm Grundkupfer	≥ 260 µm
	Leiterbreite bei 105 µm Grundkupfer	≥ 250 µm
	Leiterabstand bei 105 µm Grundkupfer	≥ 320 µm
Leiterbild Innenlagen	Leiterbreite bei 70 µm Grundkupfer	≥ 145 µm
	Leiterabstand bei 70 µm Grundkupfer	≥ 150 µm
Standard	Leiterbreite bei 105 µm Grundkupfer	≥ 175 µm
	Leiterabstand bei 105 µm Grundkupfer	≥ 190 µm